

Technical Data Sheet 文件编号: HJOM-180912-3

ESP180N 系列

ESP180N 系列是低温用环氧树脂锡膏,可以适用于SMT工程,是可以在低温的回流焊条件下取得较好测试结果的产品。

应用

- 适用于SMT工程和 Die attach 工程以及需要在低温环境下进行操作的半导体行业的设备上。
- Printing 工程, Dotting 工程, Dispensing 工程的应用上都能达到最佳化。

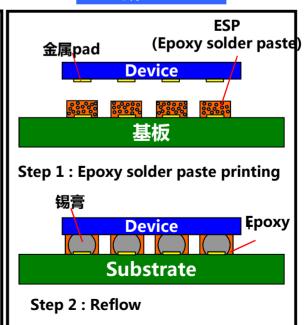
特点 & 优势

- 需要在低氧气氛或者N2气氛下 (<500ppmO2)进行回流焊 (Reflow)。
- 连续印刷时(Printing),有着非常连贯的印刷性能。
- 有着非常好的浸湿性(Wetting performance) 以及最低化的空洞率。
- 印刷后(Printing)Slump的现象较少,焊接的可靠性更强。
- 锡珠(Solder ball)发生的现象较少。
- 在微小间距的应用上非常有效果。(Pine pitch)
- 相比一般锡膏,有着更好地粘合力。
- 可以代替SMT+Under-fill 工艺转变为SMT单一工艺。

一般工艺

Substrate Step 1 : SMT Bix Step 2 : 去除flux 的残留物 Device Substrate Step 3 : Under-fill Under-fill 材料

新工艺





Technical Data Sheet 文件编号: HJOM-180912-3

焊接力度实验

Cured Epoxy resin 环氧树脂固化 \

Sn-Bi-Ag

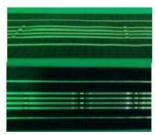


	ESP180PT4		SAC 305	
Package type	0603	1005	0603	1005
Average(g)	1034	1891	761	1282

ESP180PT4 showed higher adhesion 36%~48% than SAC305 (测试结果显示 ESP180PT4比一般 SAC305的焊接强 度高出36%~48%)

Bending 实验

- 测试方法 KS C6471
 - bending 半径 3mm, bending 速度-130cycles/min, bending 距离- 25mm
 - Total 10,000 cycles
- Test package LED package (样品尺寸: 9pcs)
- 实验结果 Resistance data Pass(电阻数据传递) (0.095ohm → 0.099ohm)









Passed bending test 10,000 cycles (通过抗弯曲实验10,000次)



产品信息

金属合金: 42Sn57.6Bi0.4Ag, 42Sn58Bi 可以根据客户的要求添加金属合金。

锡粉粒径: Type 4 (20~38um), Type 5 (10~25um), Type 6 (5~15um)

包装:500g,可根据客户要求定制。

物理性特性

Spec.		Unit	Value	Measured
颜色		-	Gray	Visual
Specific gravity (比重)		-	8.7	-
触变指数(TI)		-	0.4~0.7	MALCOM
粘度 @ 25℃		Pa.S	LV (40~80) MV (80~140) HV (140~ 230)	MALCOM(10rpm)
Тд		°C	72	TMA
热导率		W/mK	40	Laser Flash Diffusivity
Bending test 弯曲测试		-	10,000 pass	KS C6471
SIR		Ohom	>1.0×10E9	JIS Z 3284
回流焊条件		Refer to reflow profile(N2)		
锡粉 粒径		Type 4	Type 5	Type 6
金属含量 (wt%)	LV	-	-	84.5
	MV	-	-	86
	HV	-	87	88

[•]可以根据客户的工艺条件调整(金属含量及粘度)

作业时间

区分	单位	Value	备注
作业时间	hr	< 6hr	-
有效期	月	< 3个月	-40℃ 冷冻保管



Technical Data Sheet 文件编号: HJOM-180912-3

使用方法

1) 解冻

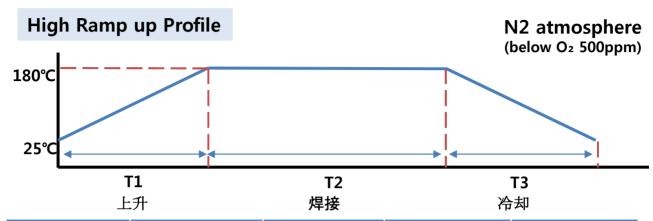
- 作业前3个小时从冷冻库里拿出产品, 在未开封的状态下进行解冻。 介于冷冻状态下开封时, 有结霜的现象可能会成为导致锡珠发生的原因。
- 在和常温相似的温度下(20~25℃)开封并使用。
- 2) 搅拌
- 推荐手动搅拌(2min ~ 3min) 请注意,过度搅拌的话会使锡膏发生物理变化。
- 机器搅拌条件如下所示。

条件(Spec.)	速度(RPM)	时间(Sec.)
自动 搅拌(Jar)	500	15~20



Technical Data Sheet 文件编号: HJOM-180912-3

回流曲线



Zone	T1	T2	Т3	峰值温度.
温度(℃)	25~180	180	138℃ 以下	100%
时间(sec)	60~100	120~160	3~8℃/sec	180℃